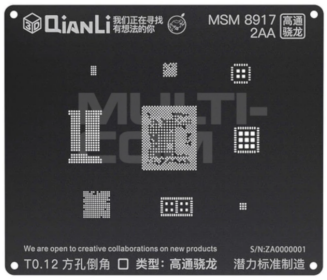

Matryca/sita 3D BGA do reballingu dla MSM 8917 2AA -QIANLI iBlack3D

ID produktu: 22459

Cena netto: **35,77 PLN**

Cena brutto: **44,00 PLN**

Waga: **0,20 kg**

Opis produktu:

Matryca/sita 3D BGA do reballingu dla MSM 8917 2AA -QIANLI iBlack3D to szybki i precyzyjny reballing układów. Funkcja 3D sprawia, że mocowanie układu jest 100% dokładne. Wycinane laserowo dzięki temu zachowana jest precyzja. Kolor czarny ułatwia odróżnienie szablonu od układu.

Przejdź do produktu

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 17 227 00 25
Infolinia:0 801 671 717
E-mail: biuro@multi-com.pl
Skype: Multi-COM

Adres:
Multi-COM Sp. z o.o.
ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b
36-100 Kolbuszowa
POLSKA